



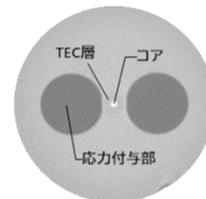
## コア拡散ファイバ

## コア拡散ファイバ

- 融着時の熱でモードフィールド径が拡大する、熱拡散コア技術を適用しました。
- シリコンフォトニクスデバイスとの結合に適しています。

## TEC PANDA ファイバ

- 高い寸法精度と円形の応力付与部により優れた偏波保持を実現しております。
- 低損失、低偏波クロストーク、融着接続や光コネクタに適した構造を実現しております。
- 一般的なアクリレート被覆より耐熱性を向上させ、 $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +150\text{ }^{\circ}\text{C}$ の広い温度範囲で使用可能です。



項目	TEC13-15-PS-U25HT-M4
波長帯	1310 nm 及び 1550 nm
モードフィールド径 ( $\mu\text{m}$ )	$3.4 \pm 0.4 @ 1310\text{ nm}$ 、 $4.0 \pm 0.3 @ 1550\text{ nm}$
コア偏心量 ( $\mu\text{m}$ )	$\leq 0.5$
クラッド外径(長径) ( $\mu\text{m}$ )	$125 \pm 1$
伝送損失 (dB/km)	$\leq 50 @ 1310\text{ nm}$ 、 $\leq 35 @ 1550\text{ nm}$
カットオフ波長 (nm)	$\leq 1280$
曲げ損失 (dB, R5 mm $\times$ 10 ターン)	$\leq 0.01 @ 1550\text{ nm}$
曲げ偏波クロストーク (dB, R5 mm $\times$ 5 ターン)	$\leq -25 @ 1550\text{ nm}$
ビート長 (mm)	$\leq 5.0 @ 1550\text{ nm}$
許容曲げ半径	2%ブルーフ品: R5 mm
被覆材質	UV 硬化型樹脂
被覆外径 ( $\mu\text{m}$ )	$245 \pm 15$
断面イメージ	